

厦门信达股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额

经中国证券监督管理委员会于2016年01月12日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]62号文核准，本公司于2016年01月20日向6名特定对象非公开发行人民币普通股95,729,013股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币13.58元，募集资金总额计为人民币1,299,999,996.54元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币19,499,999.95元后，本公司收到募集资金人民币1,280,499,996.59元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币2,352,967.96元后，实际募集资金净额为人民币1,278,147,028.63元（以下简称：“募集资金”）。截至2016年01月26日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具【2016】京会兴验字第62000007号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2019年12月31日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

公司	开户行	账号	初始存入金额	截止日 余额	备注
厦门信达股份有限公司	厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部	902011101001 0000156258	160,000,000.00	0.00	已销户
厦门信达物联科技有限公司	厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部	902011101001 0000157940		0.00	已销户
厦门信达股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行	360401550000 00108	618,147,028.63	0.00	2020年1月 21日销户
福建省信达光电科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行	360401545000 00020		0.00	2020年1月 14日销户
厦门市信达光电科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行	360401545000 00038		0.00	2020年1月 14日销户
厦门信达股份有限公司	厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部	902011101001 0000156332	110,000,000.00	0.00	已销户
厦门市信达光电科技有限公司	厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部	902011101001 0000158443		0.00	已销户
广东信达光电科技有限公司	厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部	902011101001 0000156651		0.00	已销户
厦门信达股份有限公司	兴业银行厦门湖里支行 (注)	129920100100 255895	390,000,000.00	22,112.67	2020年1月 17日销户
合计		——	1,278,147,028.63	22,112.67	——

说明：截至2019年12月31日，2015年非公开发行股票募集资金使用完毕，存储余额22,112.67元为募集资金产生的利息，已于2020年1月31日前全部转至一般账户使用。截至2020年1月31日，2015年非公开发行股票相关募集资金专项账户全部注销完毕。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

经与本公司2015年6月24日、2015年11月5日召开的2015年第一次临时股东大会、2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票

方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司 2015 年非公开发行股票预案的议案》等议案的相关内容逐项对照，编制了附件一（1）：前次募集资金实际使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件一（1）。

1、经公司第九届董事会2016年度第五次会议、2016年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品扩产项目”的募集资金投资额为61,814.70万元。为了充分利用公司现有厂房和加快公司LED封装产能升级，进一步增强公司LED封装的综合竞争力，公司拟将“信达光电LED封装及应用产品扩产项目”中的新建厂房和LED白光封装及应用产品生产线扩产项目变更为扩建4条LED封装产品生产线与新建LED产品综合实验室项目。项目名称由原“信达光电LED封装及应用产品扩产项目”变更为“信达光电LED封装扩产项目”，本次募集资金投资项目变更涉及金额总计61,814.70万元，占本次非公开发行股票募集净额的48.36%。

2、经公司第十届董事会2017年度第三次会议、2017年第三次临时股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司原计划于“信达物联安防技术服务平台项目”使用募集资金16,000.00万元。为了提升公司RFID电子标签产能，进一步增强公司物联网整体解决方案的综合竞争力，公司将“信达物联安防技术服务平台项目”的部分募集资金用于RFID产品设计和生产线的扩产，项目名称由原“信达物联安防技术服务平台项目”变更为“RFID产品设计和生产线二期扩建项目”，本次募集资金投资项目变更涉及金额总计14,983.99万元及募集资金专户后期利息收入，占本次非公开发行股票募集总金额的11.52%。

3、经公司第十届董事会2018年第二次会议、2018年第三次临时股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为适应LED封装市场发展的趋势，进一步布局并扩大高端产品市场，提升募集资金投入设备的使用效率，公司将“信达光电LED封装扩产项目”部分已投产设备租借给厦门市信达光电科技有限公司使用，该部分设备原值共计6,666.38万元，租赁期两年，租金为55.56万

元/月，本次募集资金投资项目用途变更占本次非公开发行股票募集总金额的5.13%。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况详见本报告附件一（1）。

前次募集资金项目的实际投资金额与承诺投资金额的差异主要原因如下：

1、在项目的实施过程中，项目所需设备的性能有所提升，公司根据实际市场需求及募投项目的实际情况，对设备采购计划进行调整，以最优投入基本达到计划产能目标，同时，所用设备的采购价格出现一定幅度下降，从而减少了部分资金投入。

2、公司在保证项目质量和控制风险的前提下，认真把控项目各环节，合理降低项目实施费用。随着募投项目的持续开展，公司在项目实施方面逐步积累经验，有效提升项目实施效率，间接压缩部分项目支出。

3、基于上述因素，募投项目相应的场地装修、建设支出费用随之减少。

4、募集资金在存放期间产生了一定的利息收入。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司2015年第三次临时股东大会审议通过：如本次非公开发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后，予以置换。

2015年公司董事会审议通过《非公开发行股票预案》，自2015年6月9日至2016年3月31日，公司以自筹资金先期投入募投项目的实际金额为33,375,554.36元，具体情况为：（1）信达光电LED显示屏封装产品扩产项目30,615,566.35元；（2）信达物联安防技术服务平台项目2,759,988.01元。2016年7月21日，董事会会议审议过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用2015年非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为33,375,554.36元。

截至2016年12月31日，公司对上述预先投入募集资金已置换完毕。

（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（六）前次募集资金未使用完毕的情况

2019年12月30日，公司召开二〇一九年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目结项并将节余募集资金及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金，补充流动资金后，募集资金使用完毕。上述节余募集资金21,586.90万元已于2019年12月31日前全部转至一般账户使用，并办理完毕各募集资金专项账户销户手续。本次使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。

截至2019年12月31日，公司2015年非公开发行股票募投项目结项，募集资金使用完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

经与2015年6月24日、2015年11月5日召开的2015年第一次临时股东大会、2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司2015年非公开发行股票预案的议案》等议案的相关内容逐项对照，编制了附件二（1）：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况

本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

附件一（1）：前次募集资金使用情况对照表

附件二（1）：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十四日

附件一（1）

前次募集资金使用情况对照表

2015 年非公开发行股票

单位：人民币万元

募集资金总额：			127,814.70			已累计使用募集资金总额：			107,360.60	
变更用途的募集资金总额：			83,465.07			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			65.30%			2016 年度			63,774.59	
其中：2016 年信达光电 LED 封装扩产项目			61,814.70			2017 年度			10,307.91	
2017 年“RFID 产品设计和生产线二期扩建项目			14,983.99			2018 年度			19,484.25	
2018 年信达光电 LED 封装扩产项目			6,666.38			2019 年度			13,793.85	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目预计达到
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	信达物联安防技术服务平台项目	信达物联安防技术服务平台项目	16,000.00	1,096.54	1,096.54	16,000.00	1,096.54	1,096.54	0.00	已完工
2	RFID 产品设计和生产线二期扩建项目	RFID 产品设计和生产线二期扩建项目		14,983.99	12,826.00		14,983.99	12,826.00	-2,157.99	已完工
3	信达光电 LED	信达光电 LED	64,000.00	61,814.70	43,422.95	64,000.00	61,814.70	43,422.95	-18,391.75	已完工

	封装扩产项目	封装扩产项目								
4	信达光电 LED 显示屏封装产品扩产项目	信达光电 LED 显示屏封装产品扩产项目	11,000.00	11,000.00	11,015.10	11,000.00	11,000.00	11,015.10	15.10	已完工
5	补充流动资金	补充流动资金	39,000.00	39,000.00	39,000.01	39,000.00	39,000.00	39,000.01	0.01	不适用
	小计	——	130,000.00	127,895.23	107,360.60	130,000.00	127,895.23	107,360.60	-20,534.63	——

说明 1、“信达光电 LED 封装及应用产品扩产项目”变更为“信达光电 LED 封装扩产项目”，主要系 LED 行业封装市场需求不断增长，变更可有效利用现有场地资源，解决公司 LED 封装产能瓶颈，提升市场占有率，扩大和稳定市场地位，提升公司竞争力。该事项已经公司第九届董事会 2016 年度第五次会议，2016 年第二次临时股东大会审议通过；决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见 2016 年 7 月 23 日公布在中国证监会指定网站的公司公告。

“信达物联安防技术服务平台项目”变更为“RFID 产品设计和生产线二期扩建项目”，主要系原项目由于终端市场和客户消费习惯还需培育，项目进度未达到预期，预计无法实现原定目标；而变更有利于扩大公司 RFID 电子标签产能，提高公司在鞋服零售行业物联网整体解决方案的开发能力，从而提高募集资金使用效率，提升市场竞争力。该事项已经公司第十届董事会 2017 年度第三次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过；决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见 2017 年 8 月 30 日公布在中国证监会指定网站的公司公告。

公司将“信达光电 LED 封装扩产项目”部分已投产设备租借给厦门市信达光电科技有限公司使用，主要为适应 LED 封装市场发展的趋势，进一步布局并扩大高端产品市场，提升募集资金投入设备的使用效率。该事项已经公司第十届董事会 2018 年第二次会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过，决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见 2018 年 3 月 31 日公布在中国证监会指定网站的公司公告。

注：“信达光电 LED 封装扩产项目”募集资金用途变更包含上述第 1 项及第 3 项变更。

附件二（1）

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2015年非公开发行股票

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017年度	2018年度	2019年度		
1	信达物联安防技术服务平台项目	不适用	不适用	-50.64	-11.89	0.00	-62.53	否
2	RFID 产品设计和生产线二期扩建项目	不适用	不适用	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
3	信达光电 LED 封装扩产项目	65%	不适用	-3,178.98	-60.85	-3,466.32	-6,706.15	否
4	信达光电 LED 显示屏封装产品扩产项目	85%	不适用	-847.95	-16.63	-2,149.86	-2,403.97	否
5	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	——	——	——	-4,077.57	-89.37	-5,616.18	-9,172.65	——

对前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明如下：

1. 实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况：“补充流动资金项目”主要用于补充公司流动资金，对提高公司整体效益有积极的促进作用，效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

3. “信达物联安防技术服务平台项目”通过建立全国性的服务网点来搭建信达物联安防技术服务平台，为各类安防产品提供线上、线下、售前、售后安装、维护等一体化服务，该项目已终止，剩余募集资金用于 RFID 产品设计和生产线的扩产，项目名称变更为“RFID 产品设计和生产线二期扩建项目”；“RFID 产品设计和生产线二期扩建项目”于 2019 年 12 月 31 日达预定可使用状态；“补充流动资金项目”主要用于补充公司流动资金，故上述三个项目无法计算截止 2019 年 12 月 31 日投资项目累计产能利用率。